

4

3

2

1

1 KOAX STECKVERBINDER NACH CECC 22220
COAX CONNECTOR COMPLIES WITH SPEC. CECC 22220

NICHT VERMASSTE KANTEN
SIND NICHT MAßSTÄBLICH

ÄNDERUNGEN DIE DEM TECH-
NISCHEN FORTSCHRITT DIENEN,
BEHALTEN WIR UNS VOR

GEGENSTECKER/KONTAKT:
MATED WITH:

829804-1

ZEICHNUNG GESCHÜTZT DURCH
COPYRIGHT 1994
AMP DEUTSCHLAND GMBH
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

REV.	ÄNDERUNG	DATUM	NAME
B	NEW MATERIAL FOR POS 5 and 6	09.07.99	CLAIVAZ
C	Obsolete parts SR10-0050-03	10.02.03	M VS
C1	Show one part active SR10-0006-04	11 AUG 04	Leenan

2 KUPPLER MONTIERT UND IM PLASTIKBEUTEL VERPACKT
JACK ASSEMBLED AND PACKED IN PLASTIC BAG

3 VERGOLDET 112-162-5; 1.3µm MIN DICKE ÜBER
Ni 112-25-2; 2.0µm MIN - 4.0µm MAX DICKE
GOLD PL. 112-162-5; 1.3µm MIN THK OVER
Ni PL. 112-25-2; 2.0µm MIN - 4.0µm MAX THK

4 VERGOLDET 112-162-5; 0.8µm MIN DICKE ÜBER
Ni 112-25-2; 2.0µm MIN - 4.0µm MAX DICKE
GOLD PL. 112-162-5; 0.8µm MIN THK OVER
Ni PL. 112-25-2; 2.0µm MIN - 4.0µm MAX THK

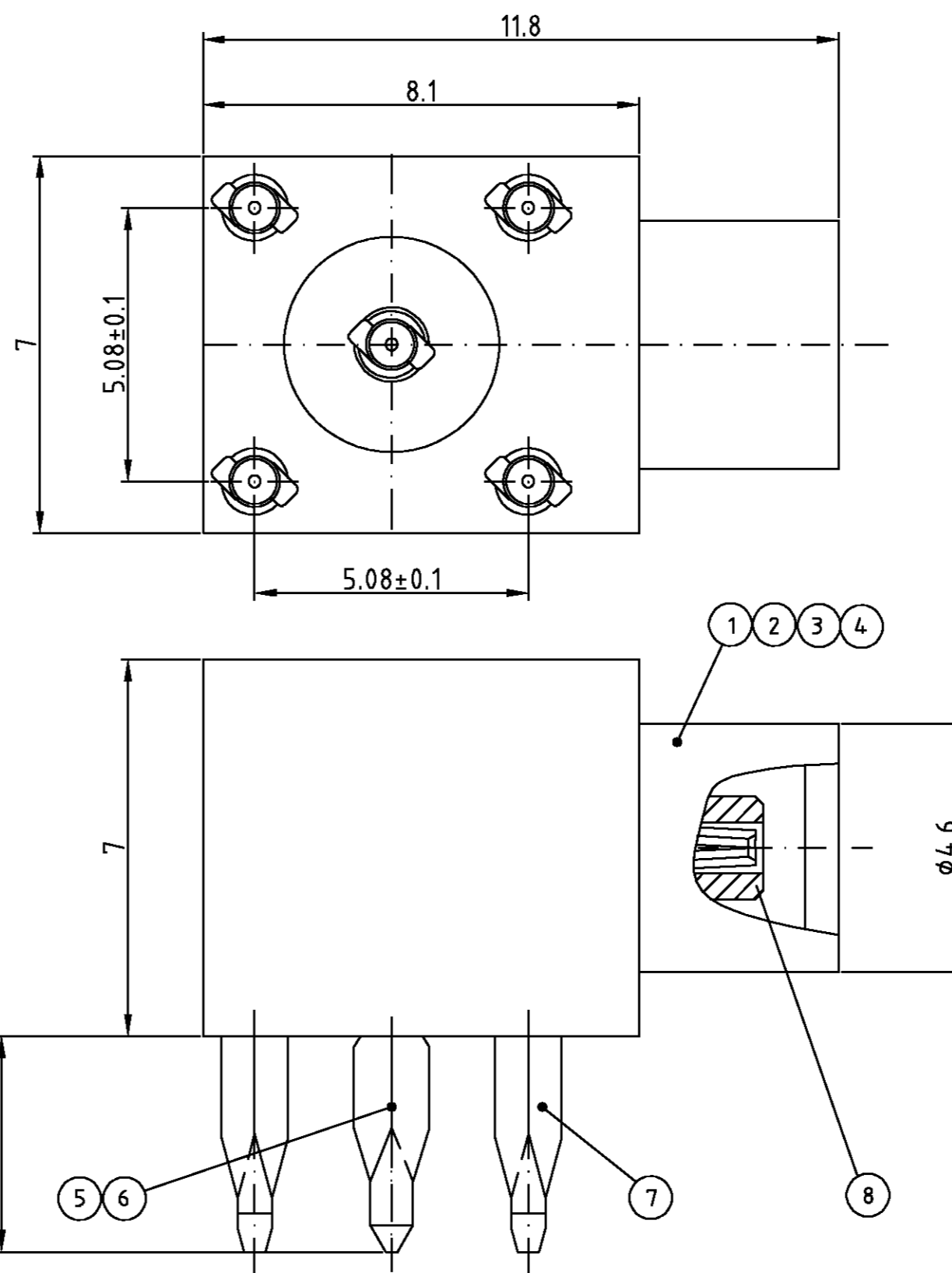
5 VERGOLDET 0.1-0.2µm DICKE ÜBER
NOM. 4.0µm NiP-SCHICHT.
0.1-0.2µm Au-PLATING OVER
NOM. 4.0µm NiP-PLATING.

6 VERNICKELT NACH AMP SPEZ. 112-25-2;
2.0µm MIN.-4.0µm MAX. DICKE.
Ni-PL. PER AMP SPEC. 112-25-2;
2.0µm MIN.-4.0µm MAX. THK.

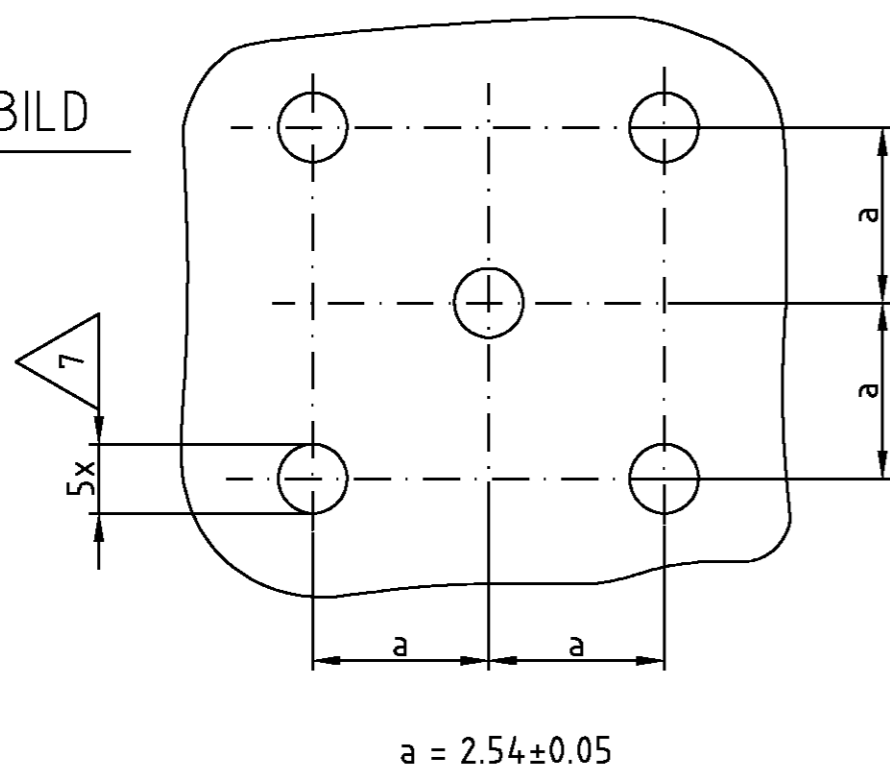
7 DURCHMETALLISIERTE BOHRUNG
DURCHMESSER GEBOHRT: $\phi 1.15 \pm 0.025$
Cu-SCHICHT: 25 - 75 µm
Sn/Pb SCHICHT: 4 - 10 µm
BOHRUNG GALVANISIERT: $\phi 0.94 - 1.09$ mm
BOHRUNG AUFGESCHMOLZEN: $\phi 0.91 - 1.09$ mm
PLATED THROUGH HOLE
DRILLED HOLE: $\phi 1.15 \pm 0.025$
Cu THICKNESS: 25 - 75 µm
Sn/Pb THICKNESS: 4 - 10 µm
FINISHED HOLE: $\phi 0.94 - 1.09$ mm
AFTER REFLOW: $\phi 0.91 - 1.09$ mm

8 SnPb OBERFLÄCHE NACH SPEC.
R-045.046-3.1.9. NOM. 1.3µm
SnPb PLATING PER SPEC.
R-045.046-3.1.9. NOM. 1.3µm

9 ACTION PINS ENTSPRECHEN AMP SPEZ. 108-26003.
MINIMALE LEITERPLATTENDICKE: 1.6mm
ACTION PINS ACCORDING TO AMP SPEC. 108-26003.
MINIMUM PCB-THICKNESS: 1.6mm



LEITERPLATTENBILD
PCB-LAYOUT



OBSOLETE	POS.	STÜCK	BENENNUNG EINZELTEIL	WERKSTOFF	OBERFLÄCHE FARBE
966741-4	8	1	ISOLIERSTUETZE/DIELECTRIC	PTFE	8
	7	4	AUSSENKONTAKT/OUTER CONTACT	CuSn	8
	5	1	BUCHSENKONT./FEMALE CONTACT	CuBe / Phosphorbranze	5
	4	1	GEHÄUSE / SHELL	CuZn	6
966741-3	8	1	ISOLIERSTUETZE/DIELECTRIC	PTFE	8
	7	4	AUSSENKONTAKT/OUTER CONTACT	CuSn	8
	6	1	BUCHSENKONT./FEMALE CONTACT	CuBe / Phosphorbranze	3
	3	1	GEHÄUSE / SHELL	CuZn	3
966741-2	8	1	ISOLIERSTUETZE/DIELECTRIC	PTFE	8
	7	4	AUSSENKONTAKT/OUTER CONTACT	CuSn	8
	6	1	BUCHSENKONT./FEMALE CONTACT	CuBe / Phosphorbranze	3
	2	1	GEHÄUSE / SHELL	CuZn	4
966741-1	8	1	ISOLIERSTUETZE/DIELECTRIC	PTFE	8
	7	4	AUSSENKONTAKT/OUTER CONTACT	CuSn	8
	5	1	BUCHSENKONT./FEMALE CONTACT	CuBe / Phosphorbranze	5
	1	1	GEHÄUSE / SHELL	CuZn	5
BESTELL-NR.	POS.	STÜCK	BENENNUNG EINZELTEIL	WERKSTOFF	OBERFLÄCHE FARBE
			12-XX-96	D. Bozzer	12-XX-96

ZEICHNUNG GÜLTIG AB 33/04



DSM AN AMP COMPANY
St Maurice, Switzerland

BENENNUNG
COAXICON • SERIE MCX, KUPPLER FUER PCB,
90°, ACTION PIN, (RASTER 5.08)
COAXICON • SERIES MCX, JACK FOR PCB,
90°, ACTION PIN, (PITCH 5.08)

C

FORMAT A2
ZEICHNUNG-NR. 966741

MAßSTAB 10:1
BLATT 1 VON 1
REV. C1

NUMMER 966741

VERWENDET FÜR

PASSEND ZU

CAD-ORIGINAL
ZEICHNUNG NICHT ÄNDERN

LOC EK
DIST

WAR NR.